

RESINES EPOXY ET POLYIMIDE, ELECTROCONDUCTRICES, MONOCOMPOSANT*

REF	RETICULATION Recommandée	DUREE DE VIE en pot	VISCOSITE	Tg	DEGRADATION	CHARGE	COEFFICIENT DE DILATATION		RESISTIVITE	UTILISATIONS
							AVANT TG	APRES TG		
E207-1	1 à 7 jours à 25°C	4 h à 25°C	3,5 Pa.s	30-60°C	390-400°C	74%	50-60.10 ⁻⁶ /°C	120-140.10 ⁻⁶ /°C	<0,2 mΩ.cm	Collage conducteur dans les cartes à puces - Faible viscosité - Réticulation à température ambiante
E208	1 min à 150°C	6 h à 25°C	5,5 Pa.s	70-90°C	390-400°C	74%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Collage sur cartes à puces - Collage de diodes sur clavier souple - Réticulation rapide
E208FV	1 min à 150°C	8 h à 25°C	12,5 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Résine fluide - Collage sur cartes à puces, claviers souples
E209	30 min à 150°C	3 mois à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	430-450°C	60%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Bonne adhésion sur brasure étain/plomb
E211	10 min à 150°C	7 jours à 25°C	3 Pa.s	70-90°C	420-440°C	75%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	100-130.10 ⁻⁶ /°C	<0,2 mΩ.cm	Condensateurs tantale - Durée de vie en pot supérieure à 7 jours
E211FV	1 min à 150°C	18 h à 25°C	10 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Version de la E211 plus réactive
E211HV	1 min à 150°C	21 h à 25°C	13 Pa.s	70-90°C	390-400°C	75%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	110-120.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Version de la E211 plus réactive - Durée de vie en pot > 20 h
E213LF	5 min à 150°C	2 jours à 25°C	15 Pa.s	70-80°C	390-410°C		40-50.10 ⁻⁶ /°C		<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de condensateurs tantale
E214	5 min à 150°C	24 h à 25°C	25 Pa.s	70-90°C	> 350°C	75%		90-100.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Version monocomposant de la résine E203
E214SC	2 à 3 jours à 20°C	8 h à 25°C	25 Pa.s	40-50°C	> 350°C		40-50.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Monocomposant - Réticulation à température ambiante
E216HV	10 min à 150°C	7 jours à 25°C	15 Pa.s	70-100°C	420-440°C	79%	40-50.10 ⁻⁶ /°C	100-130.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Collage de composants de grande dimension
E216LF	1 h à 150°C	5 jours à 25°C	25 Pa.s	50-80°C	380-410°C		35-45.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<0,3 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Connexions électriques
E217	1 h à 150°C	7 jours à 25°C	15 Pa.s	-35 à -25°C	> 350°C	80%		150-180.10 ⁻⁶ /°C	<15 mΩ.cm	Collage conducteur de grande souplesse - Destiné aux quartz hautes fréquences
E217LF	1 h à 150°C	5 jours à 25°C	12,5 Pa.s	30-35°C	430°C		60-65.10 ⁻⁶ /°C		<1 mΩ.cm	Adapté aux technologies "lead free" - Collage de larges puces
E217SC	3 min à 150°C	2 jours à 25°C	15 Pa.s	< -30°C	325°C			140.10 ⁻⁶ /°C	<5 mΩ.cm	Collage de condensateurs tantale
E218	15 min à 170°C	24 h à 25°C	15 Pa.s	60-70°C	440°C		55-60.10 ⁻⁶ /°C	150-160.10 ⁻⁶ /°C	<1000 mΩ.cm	Collage conducteur des terminaisons de composants
P200	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	10 Pa.s	190-210°C	> 550°C	64%	28-30.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	< 0,5 mΩ.cm	Résine polyimide. Collage conducteur avec tenue à haute température. Réalisation pistes conductrices
P202	1 h à 150°C + 1 h à 275°C	6 mois à 25°C	100 Pa.s	190-210°C	> 550°C		28-30.10 ⁻⁶ /°C	90-100.10 ⁻⁶ /°C	<1 mΩ.cm	Résine polyimide. Collage conducteur avec tenue à haute température. Réalisation pistes conductrices

Les informations sur cette fiche sont basées sur des mesures et des données que nous croyons exactes. Elles n'ont qu'une valeur significative et nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais dans leurs conditions réelles d'emploi.

* Pour plus de précision sur les valeurs techniques, se reporter aux fiches techniques individuelles

Maj 27/10/09

épotecny

9 rue Aristide Briand - 92300 Levallois Perret - France Tel : 33 (0)1-47-57-54-34 Fax : 33 (0)1-47-57-54-74 - e-mail : epotecny@epotecny.com - Site Web : www.epotecny.com